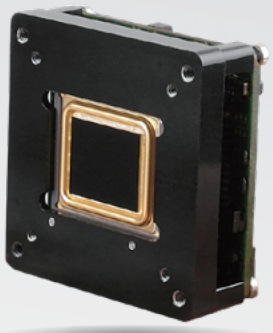
机芯产品
M系列

M502/M502C
红外热成像机芯



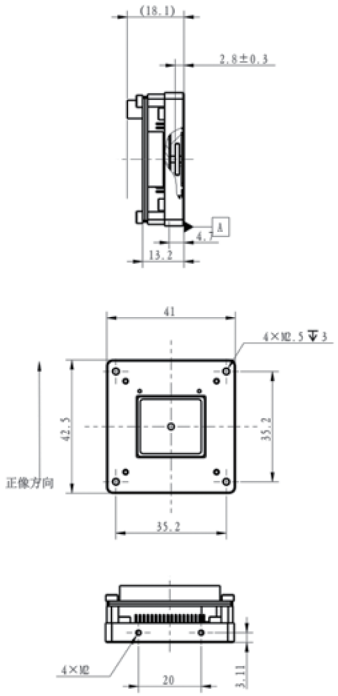
产品特点

- 专利无挡片技术(NST)
- 高分辨率: 640 x 480
- 极低功耗<1.2W
- 瞬时开机<4s
- 实时图像输出，零帧损
- 低工作电压: +2.5V~+5.5V
- 小尺寸(42.5mmx41mmx19mm)重量轻(<40g)
- 抗热冲击性高，环境适应性强
- 专用的结构加固设计，抗振动冲击性能强

应用领域

无人机搜救、便携式产品及港口码头、高速公路、石油石化等安防视频监控领域

产品尺寸



技术参数

特点 / 性能	M502	M502C
探测器性能		
探测器类型	非晶硅红外微测辐射热计	
分辨率/ 像元间距	640x480/17μm	
灵敏度	≤50mk@300K.F1	
帧频	50Hz	
响应波段	8~14μm	
光学性能		
镜头	可选配19mm, 40mm,50mm,75mm,100mm,150mm	
图像处理		
非均匀校正技术	采用NST专利无挡片技术	
开机时间	<9s	
图像降噪	数字滤波	
图像功能	图像勾边、图像细节增强、智能宽动态	
图像显示分辨率	768x576/640x480 可选	
图像帧频	50Hz(PAL)/60Hz(NTSC)可选	
图像调节		
伪彩色		8种伪彩色可选
极性反转	黑热/白热	
图像镜像	水平/垂直	
图像放大	x2, x4	
手动增益	可循环调节	
自动增益	自动调节	
电源		
工作电压范围	DC:+2.5V~+5.5V	
典型工作电压	DC:+3.6V	
功耗	<1.1W	
反接保护	有	
过欠压保护	有	
环境参数		
工作温度范围	-40°C~+60°C	
存储温度范围	-45°C~+65°C	
湿度	≤90%RH	
抗振动冲击	振动：GJB 150-16 2.3.1	
	冲击：GJB 150-18试验7 100g/6ms	
抗温度冲击	5°C/min(-40°C~+60°C)	
物理参数		
重量	<40g(不带镜头和后罩)	
尺寸	42.5mm x 41mm x 19mm/ 42.5mm x 51mm x 19mm(不带镜头和后罩)	
控制接口		
通讯口	RS-232	
键盘	4按键键盘	
视频接口		
模拟视频输出口	两路视频	
数字视频输出口	16Bit(50Hz)	